

SLPC2022 第 4 回スマートレーザプロセス会議 開催趣意書

The 4th Smart Laser Processing Conference

会議名称	SLPC2022 第 4 回スマートレーザプロセス会議 The 4th Smart Laser Processing Conference
会 期	2022 年 4 月 19 日 (火) ~ 4 月 21 日 (木)
会 場	パシフィコ横浜・会議センター (〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1)
会議 URL	http://www.jlps.gr.jp/slpc2022/
主催団体	一般社団法人レーザ加工学会 Japan Laser Processing Society (JLPS) 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 11-1 大阪大学接合科学研究所気付 (共通研究棟 2F 213 号室) TEL/FAX: 06-6879-8642, E-mail: slpc@jlps.gr.jp 主催団体ホームページ: http://www.jlps.gr.jp/
共催	大阪大学接合科学研究所
併 催	Optics & Photonics International Congress 2022 (OPIC2022) 2022 年 4 月 18 日~22 日 (主催: OPIC 協議会)
主な委員 (敬称略)	チエア 塚本雅裕 (大阪大学 接合科学研究所) 実行委員長 佐藤雄二 (大阪大学 接合科学研究所) プログラム委員長 甲藤正人 (宮崎大学)
概 要	SLPC2022 は、オプティクス・フォトニクス国際会議 (OPIC2022 - OPTICS & PHOTONICS International Congress 2022) の専門会議の一つとして開催されます。レーザによるマイクロ・ナノ加工を中心として、基礎科学から産業応用までを広く議論する国際会議です。当該分野において、基礎研究者、エンドユーザー、レーザマニュファクチャラーが一堂に会し、レーザと材料の相互作用の基礎科学からレーザ加工技術の現状、次世代のレーザ加工のトピックスまでをカバーすることを目的としています。また、OPIC2022 では、レーザ光源及びレーザ利用に関する 15 の専門会議 (SLPC を含む) が同時開催され、SLPC2022 参加者はそれらの会議全てに参加することができます。
トピックス (予定)	Cutting, Welding, Additive Manufacturing / Selective Laser Melting, Cladding / Laser Metal Deposition, Functional Surface Manufacturing, Laser Peening and Related Phenomena, Laser Polishing / Cleaning, Short Wavelength Application, Micro Nano Processing, Ultrashort Pulsed Laser Processing, Advanced Lasers and Optical Technologies, CFRP Processing, Industrial Applications, AI / CPS Laser Processing, High Power Blue and Green Laser, Others
過去の開催	<p><u>SLPC2018 パシフィコ横浜</u> : 2018 年 4 月 24 日~26 日 発表件数 : 11カ国 58 件 (基調 2、招待 8、一般口頭 20、ポスター 28 件) 国内 32 件、海外 26 件、海外比率 45 % 参加者数 : 79 名 (国内 45、海外 34、海外比率 43 %)</p> <p><u>SLPC2016 パシフィコ横浜</u> : 2016 年 5 月 17 日~19 日 発表件数 : 14カ国 59 件 (招待 12 件を含む) 国内 28 件、海外 31 件、海外比率 52.5% 参加者数 : 93 名 (国内 59、海外 34、海外比率 : 36.6%)</p> <p><u>SLPC2014 パシフィコ横浜</u> : 2014 年 4 月 22 日~24 日 発表件数 : 12カ国 51 件 (招待 16、一般口頭 20、ポスター15 件) 国内 21、海外 30、海外比率 58.8% 参加者数 : 86 名 (国内 46、海外 40 名、海外比率 : 46.5%)</p>